

Kupferbad SLOTOCOUP CU 1370

Das Kupferbad SLOTOCOUP CU 1370 wird bei der Produktion von Leiterplatten für den Automotivbereich eingesetzt. Der Elektrolyt wird mit Gleichstrom betrieben und ermöglicht eine sehr gute Streuung in Bohrungen mit hohem Aspektverhältnis.

Die aus dem Kupferbad SLOTOCOUP CU 1370 abgeschiedenen Schichten sind hochglänzend. Der Elektrolyt wurde speziell für den Einsatz in vertikalen Durchlaufanlagen und für hohe Stromdichten (über 3 A/dm²) entwickelt.

Der Ansatz von Kupferbad SLOTOCOUP CU 1370 erfolgt mit drei Flüssigzusätzen.

Die Angaben in der Gebrauchsanweisung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanweisung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

Falls in den verwendeten Zusätzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern im Abschnitt 15 ausgewiesen.

